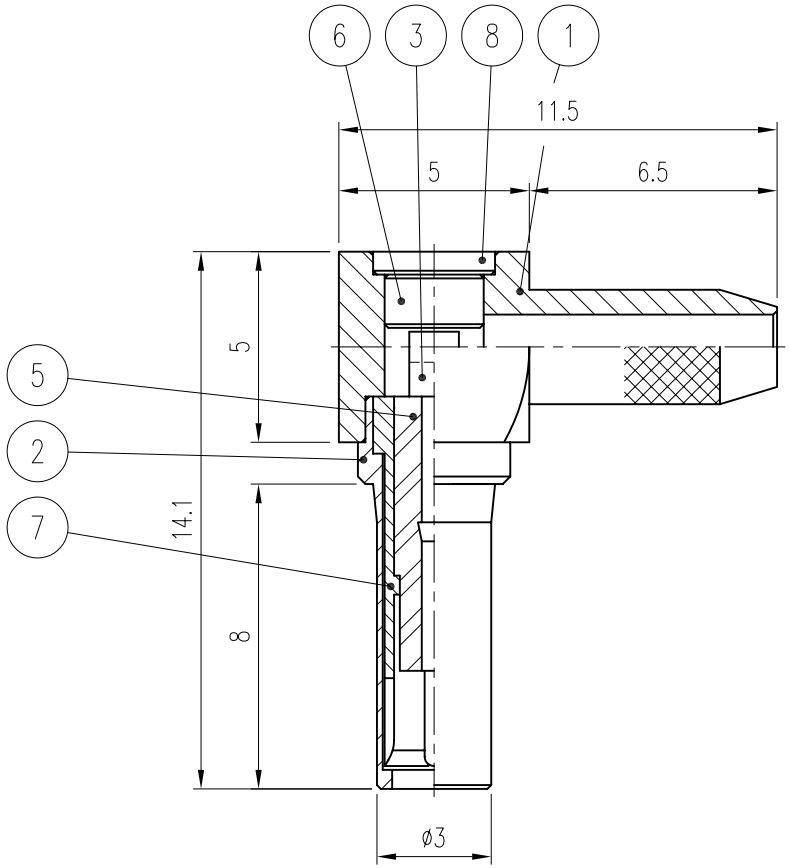
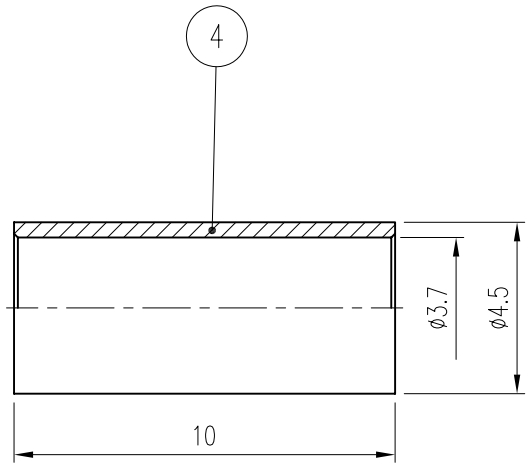
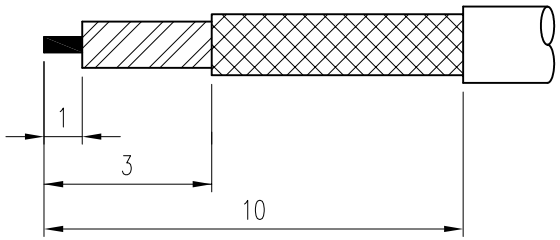
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
8	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00004-5/1(LH077)
7	JACK	1	BeCu	Gold Plate	DJA00111-5/1
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00937-N/1 (HH106)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01290-N/1
4	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00043-5/1 (F6007)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01522-5/1
2	BODY(B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01997-5/1
1	BODY(A)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01996-5/1



CABLE 탈피도

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질 _____

열처리 _____

보호피막처리 _____

년월일 2008. 4. 19.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 5/1 단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 MINI/SMB-LPS-FUJIKURA VER.0

A4

도번 CN01990-7/1